

攻めの日揮グループ 半導体事業 拡大中!

出展の
お知らせ

SEMICON[®]
JAPAN

JGC 日揮グループ

JGC 日揮ホールディングス株式会社

JGC 日揮株式会社

JGC 日揮グローバル株式会社

JGC C&C 日揮触媒化成株式会社

JFC 日本ファインセラミックス株式会社

NU 日揮ニバーサル株式会社

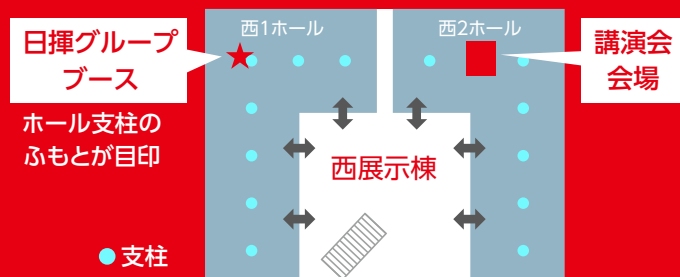
ごあいさつ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、日揮グループは、12月17日(水)から12月19日(金)にかけて東京ビッグサイトにおいて開催されます「SEMICON Japan 2025」に出展します。

ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ぜひ弊社ブースへお立ち寄り下さいますようお願い申し上げます。

敬具



会期 | 12月17日(水)~12月19日(金)
10:00~17:00

会場 | 東京ビッグサイト(西1ホール)
弊社出展小間: No.W1165

日揮グループは創業以来、石油精製・天然ガスを代表とする様々な分野のプラント・工場のEPC(設計・調達・建設)だけではなく、触媒、無機素材、ファインセラミックス部品の製造といった、多様な事業を擁しています。

半導体分野においては、“半導体関連工場の設計・施工”、“半導体製造装置向け部品”、“半導体材料向け素材”を軸に多角的に半導体産業に貢献しています。

以下の日程で開催する講演会「Exhibitor's TechSPOT」では、**日揮グループの半導体分野での取り組み実績や今後目指す半導体ビジネスの展望について**、具体例を交えてご紹介します。

講演 日揮グループが追求する半導体分野でのビジョン

■日時 ①12月17日(水) 14:30~14:50
②12月18日(木) 13:30~13:50

■場所 西2ホール Exhibitor's TechSPOT

■登壇者 日揮ホールディングス株式会社
機能材製造事業オフィス
副本部長 高 明天



講演 日揮グループの環境関連技術

■日時 12月19日(金) 13:30~15:00のうち15分

■場所 会議棟606-607

■登壇者 同上

素材よし！部品よし！建設よし！ 日揮グループ

JGC 日揮グローバル株式会社



「世界87か国のプロジェクト計画・遂行経験を、半導体へ」

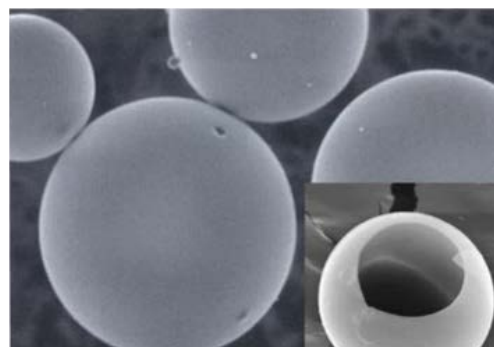
Oil & Gas分野で培ったグローバルな設計・調達・施工(EPC)実績をもとに、半導体製造工場の基本構想/Feasibility Study・設計・建設を支援します。品質と安全性を重視した施工管理と確実なプロジェクト遂行により、海外展開を技術面からサポートいたします。

- ・JGCの総合力を活かし、半導体産業向けに融合型設備ソリューションをグローバルに展開
- ・超大型案件で培ったプロジェクトマネジメント力により、コスト・スケジュール・品質を一体的にコントロール
- ・融合型設備ソリューションにより、生産設備と建屋の統合的エンジニアリングにて最適化を実現
- ・モジュール型ソリューションを通じて、スピード・標準化・柔軟性に優れた対応を提案

JGC C&C 日揮触媒化成株式会社

半導体向けを始め、様々なナノ技術を駆使した素材を製造・販売しており、触媒開発で培った要素技術を追求・応用しています。

半導体分野では、シリカを用いたシリコンウエハー研磨用やCMP用、低誘電率を有するバルーンシリカといった素材を研究・開発しています。素材の力で半導体業界に貢献します。



バルーンシリカ

JFC 日本ファインセラミックス株式会社



エンジニアリングセラミックス

半導体製造装置向けの部品を製造・販売しています。

耐熱、耐食、耐摩耗のエンジニアリングセラミックス、当社独自の金属セラミックス複合材料MMC、基板製造から薄膜回路形成まで社内一貫生産のエレクトロニクスセラミックス、次世代パワー半導体に不可欠な高熱伝導窒化ケイ素基板が半導体業界に貢献します。

半導体・環境・エネルギー領域に向けた技術開発も展示します。

n-u 日揮ユニバーサル株式会社

日揮ユニバーサルの触媒技術は、半導体製造プロセスをはじめ、様々な業界で発生する揮発性有機化合物(VOC)の除去が可能であり、環境負荷を低減することに貢献しています。高い耐久性と優れた処理性能を兼ね備えた当社の触媒技術は、クリーンで持続可能な産業活動を力強くサポートします。



お問い合わせ

日揮ホールディングス株式会社 機能材製造事業オフィス

Email : jgc_semiconductor@jgc.com